

2022年度第1回 先端電子デバイス接着技術研究会 「先端パッケージと樹脂/金属等の接着」



2022年6月28日（火）リアル（阪大産研内I-117室）+ Zoomによるハイブリッド開催

- 13:45～14:05 開会挨拶・会員紹介 大阪大学 F3D実装協働研究所 所長 菅沼 克昭
・会員紹介：東京応化工業、東亜合成（対象6社の内、2社）
- 14:05～14:50 「先端パッケージに向けたエキスパンド・プロセスの紹介」
リンテック株式会社 次世代技術革新室 & エレクトロニクス実装学会 田久 真也 氏
- 14:50～15:35 「電子顕微鏡による接着界面の可視化と接着メカニズムの解析」
産業技術総合研究所 接着・界面現象研究ラボ 堀内 伸 氏
- 15:35～15:45 ～ 休憩（10分）～
- 15:45～16:30 「フィラー用窒化アルミニウム粉末の開発」
株式会社トクヤマ 機能材料開発グループ 福永 豊 氏
- 16:30～17:15 「次世代高速通信を支えるフッ素樹脂のプラズマ表面改質技術」
大阪大学 大学院工学研究科 附属精密工学研究センター 大久保 雄司 先生
- 17:15～17:30 「本研究会の課題と運営方法」 F3D 加藤豊